电子行业周报

封测市场需求旺盛，本土封测产业链充分受益高景气行情

增持（维持）

2021 年 01 月 24 日

证券分析师 王平阳
执业证号：S0600519060001
021-60199775
wangpingyang@dwzq.com.cn

投资要点

- **半导体产能供需关系紧张，不仅前段晶圆代工产能供不应求，后段封测产能同样出现了短缺情况。**目前，全球封测龙头日月光的封测产能供不应求，已于 2020Q4 调涨封测价格，并且 2021Q1 调涨趋势依然明确，同时，国内头部封测厂商长电科技、通富微电、华天科技以及台厂力成科技也均处于封测订单饱满、产能利用率高企的状态，**封测行业景气度明显提升。**

- 从供需紧张的封测品类上看，以日月光为代表的封测厂商的**打线封装**产能紧缺严重，同时**倒装（FC）、凸块（Bumping）和晶圆级封装（WLP）**的需求也十分强劲，带动了封测厂产能需求的显著提升。

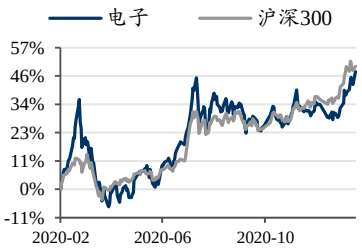
- **从供需结构上看，本轮封测产能供不应求的主要原因在于：**供给端：IC 载板、导线架等材料供应紧张，成本有所上涨。需求端：（1）5G 智能手机等新品陆续起量；（2）受疫情的影响，全球居家办公和在线教育使笔记本电脑、平板电脑和游戏机等产品的出货显著增长。（3）汽车市场特别是新能源汽车市场逐步复苏。

- **目前，封测产业链预计本次供需紧张至少将延续至 2021Q2，鉴于封测市场的旺盛需求，不少封测厂商开始规划扩建封测产能。**根据台湾工商时报的报道，**日月光购置了大量打线机台，以应对封测产能供不应求的状态。**同时，台积电未来也将在先进封装领域大力投入，计划在台湾竹南科学园区兴建先进制程封测厂，2021 年有望导入设备并正式运转，此前台积电公布 2020 年第四季度财报时，台积电 CEO 魏哲家预计**先进封测技术（InFO）将在未来实现高于公司平均增速的增长。**同时，长电科技、通富微电、华天科技、深科技等本土封测厂商也陆续规划了多项扩产计划，未来随着相关项目的达产，本土封测产业链在产能规模和先进封测技术领域的市场地位和竞争优势有望进一步凸显。

- **投资建议：**随着全球封测市场的不断发展以及国内封测厂商在封测产能配置、先进封测研发等领域的推进，本土封测产业链相关标的有望充分受益，**建议关注：长电科技、通富微电、华天科技、利扬芯片、深科技、晶方科技。**

- **风险提示：**市场需求不及预期；企业研发不及预期；市场开拓不及预期。

行业走势



相关研究

1、《电子：台积电业绩凸显半导体高景气，设备环节有望充分受益》2021-01-17

2、《电子行业周报：三星 Galaxy S21 系列手机正式发布，开启 2021 手机争锋序曲》2021-01-17

3、《2021 年电子行业年度策略报告：智能化扩散，新黄金时代》2021-01-08

请务必阅读正文之后的免责声明部分

1. 本周观点：封测市场需求旺盛，本土封测产业链充分受益高景气行情

半导体产能供需关系紧张，不仅前段晶圆代工产能供不应求，后段封测产能同样出现了短缺情况。目前，全球封测龙头日月光的封测产能供不应求，已于 2020Q4 调涨封测价格，并且 2021Q1 调涨趋势依然明确，同时，国内头部封测厂商长电科技、通富微电、华天科技以及台厂力成科技也均处于封测订单饱满，产能利用率高企的状态，封测行业景气度明显提升。

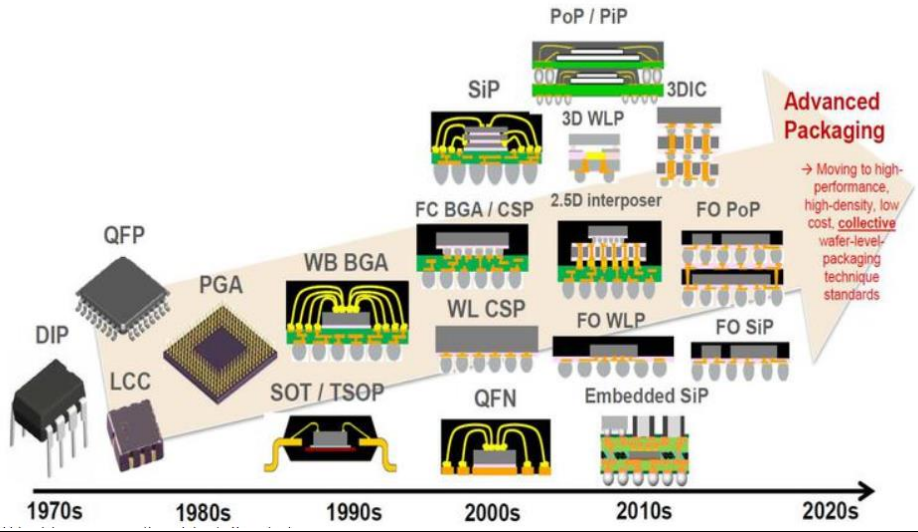
图 1：2020Q3 封测市场格局

排名	公司	2020Q3市占率
1	日月光	22.50%
2	安靠	20.00%
3	长电科技	14.50%
4	矽品	13.30%
5	力成	9.60%
6	通富微电	5.90%
7	华天科技	4.70%
8	京元电	3.70%
9	颀邦	2.90%
10	南茂	2.90%

数据来源：拓璞产业研究院，东吴证券研究所

从供需紧张的封测品类上看，以日月光为代表的封测厂商的**打线封装**产能紧缺严重，同时**倒装（FC）、凸块（Bumping）和晶圆级封装（WLP）**的需求也十分强劲，带动了封测厂产能需求的显著提升。

图 2：传统封装与先进封装的技术更迭



数据来源：Yole，东吴证券研究所

请务必阅读正文之后的免责声明部分

从供需结构上看，本轮封测产能供不应求的主要原因在于：

供给端：

IC 载板、导线架等材料供应紧张，成本有所上涨；

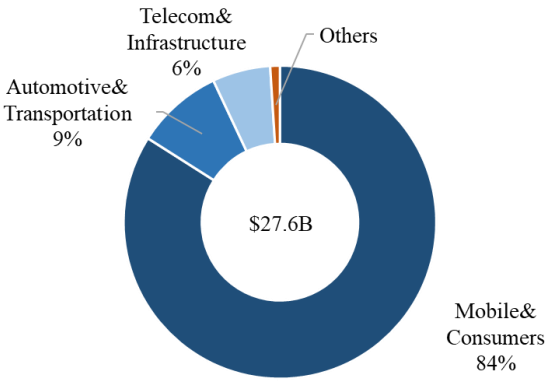
需求端：

（1）5G 智能手机等新品陆续起量；

（2）受疫情的影响，全球居家办公和在线教育使笔记本电脑、平板电脑和游戏机等产品的出货显著增长。

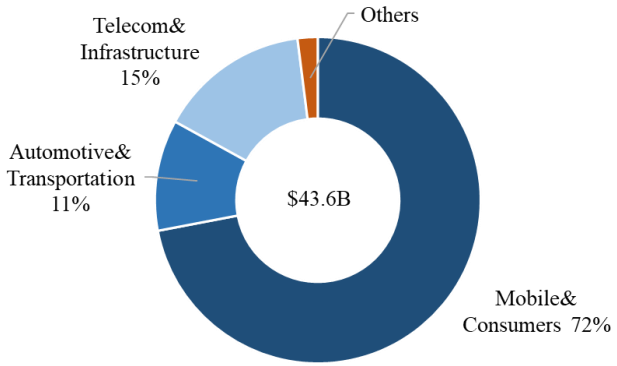
（3）汽车市场特别是新能源汽车市场逐步复苏。

图 3：2018 年先进封装应用市场占比



数据来源：Yole，东吴证券研究所

图 4：2024 年先进封装应用市场占比



数据来源：Yole，东吴证券研究所

目前，封测产业链预计本次供需紧张至少将延续至 2021Q2，鉴于封测市场的旺盛需求，**不少封测厂商开始规划扩建封测产能。**根据台湾工商时报的报道，日月光购置了大量打线机台，以应对封测产能供不应求的状态。同时，台积电未来也将在先进封装领域大力投入，计划在台湾竹南科学园区兴建先进制程封测厂，2021 年有望导入设备并正式运转，此前台积电公布 2020 年第四季度财报时，台积电 CEO 魏哲家预计先进封测技术（InFO）将在未来实现高于公司平均增速的增长。

同时，本土封测厂也陆续规划了多项扩产计划。**长电科技**拟通过非公开发行拟募集资金不超过 50 亿元，投入高密度集成电路及系统级封装模块项目和通信用高密度混合集成电路及模块封装项目。相关项目建成后，公司将具备通信用高密度集成电路及模块封装年产 36 亿块 DSmBGA、BGA、LGA、QFN 等产品的生产能力，以及通信用高密度混合集成电路及模块封装年产 100 亿块 DFN、QFN、FC、BGA 等产品的生产能力。随着相关项目的投产，公司的产品结构将得到优化，公司的市场地位及核心竞争力将得到进一步提升，从而增强公司的整体盈利能力。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

表 1：长电科技募投项目

项目名称	总投资（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目	290074.00	266000.00
年产 100 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目	221470.00	84000.00
小计	511544.00	350000.00
偿还银行贷款及短期融资券	150000.00	150000.00
合计	661544.00	500000.00

数据来源：长电科技公告，东吴证券研究所

通富微电通过非公开发行拟募集资金 32.72 亿元，投入集成电路封装测试二期工程、车载品智能封装测试中心建设、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目。相关项目建成后，公司将具备年产集成电路产品 12 亿块（其中：BGA4 亿块、FC2 亿块、CSP/QFN6 亿块）、晶圆级封装 8.4 万片的生产能力，年新增车载品封装测试 16 亿块的生产能力，以及形成年封测中高端集成电路产品 4420 万块的生产能力。随着相关项目的投产，公司在封测主营业务上的经营能力有望进一步提升，进而提高公司整体盈利水平。

表 2：通富微电募投项目

项目名称	总投资（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
集成电路封装测试二期工程	258000.00	145000.00
车载品智能封装测试中心建设	118000.00	103000.00
高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	62800.00	50000.00
补充流动资金及偿还银行贷款	102000.00	102000.00
合计	540800.00	400000.00

数据来源：通富微电公告，东吴证券研究所

华天科技拟通过非公开发行拟募集资金不超过 51 亿元，投入集成电路多芯片封装扩大规模项目、高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目、TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目、存储及射频类集成电路封测产业化项目。相关项目建成后，公司将形成年产 MCM(MCP)系列集成电路封装测试产品 18 亿只的生产能力，年产 SiP 系列集成电路封装测试产品 15 亿只的生产能力，年产晶圆级集成电路封装测试产品 48 万片、FC 系列产品 6 亿只的生产能力，以及年产 BGA、LGA 系列集成电路封装测试产品 13 亿只的生产能力。随着相关项目的投产，公司的先进封装测试产能将得到增加，盈利能力将进一步增强。

表 3：华天科技募投项目

项目名称	总投资（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
集成电路多芯片封装扩大规模项目	115800.00	90000.00
高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目	115038.00	100000.00
TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目	132547.00	120000.00
存储及射频类集成电路封测产业化项目	150640.00	130000.00
补充流动资金	70000.00	70000.00
合计	584025.00	510000.00

数据来源：华天科技公告，东吴证券研究所

深科技拟通过非公开发行拟募集资金不超过 17.1 亿元，投入存储先进封测与模组制造项目。相关项目达产后，公司 DRAM 存储芯片封装测试业务的月均产能可达 4,800 万颗，存储模组业务月均产能可达 246 万条、NAND Flash 存储芯片封装业务月均产能可达 320 万颗。随着相关项目的投产，公司的营业收入和净利润水平不断提升，为公司后续发展提供有力支持，增强公司的可持续发展能力。

表 4：深科技募投项目

项目名称	总投资（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
存储先进封测与模组制造项目	306,726.40	171,000.00

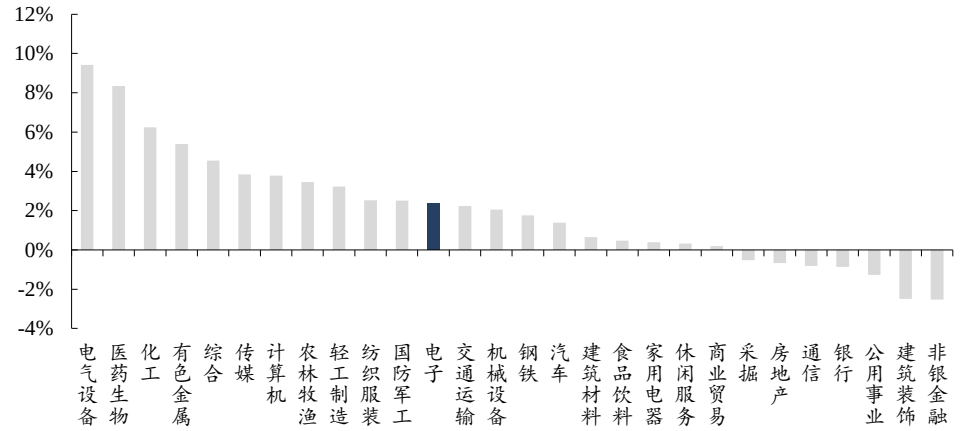
数据来源：深科技公告，东吴证券研究所

未来随着相关产能的开出，相关封测厂商有望充分受益本轮封测市场的景气行情，建议关注：长电科技、通富微电、华天科技、利扬芯片、深科技、晶方科技。

2. 市场动态

本周沪指上涨 1.13%，深证成指上涨 3.97%，创业板指上涨 8.68%。电子行业整体上涨，截至 2020 年 1 月 24 日申万电子指数为 5231.50，较上周末上涨 3.11%。行业涨跌幅在所有一级行业中排序 12/28。

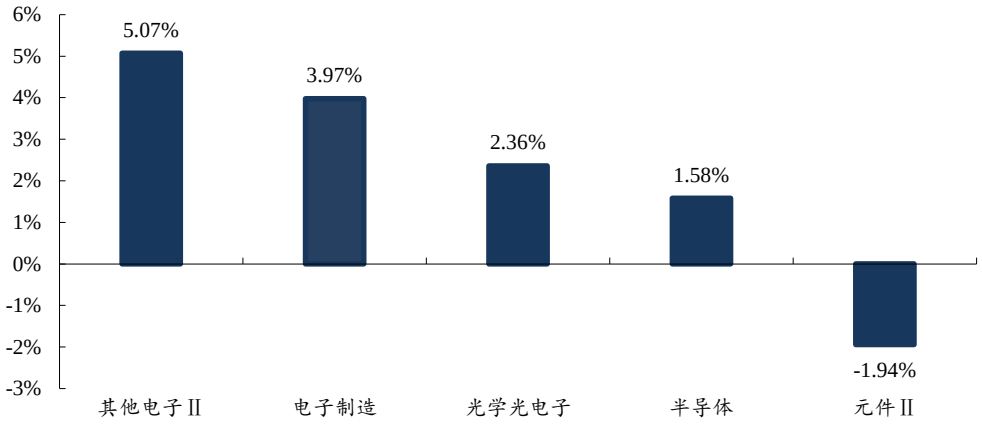
图 5：申万一级行业本周涨跌幅



数据来源：Wind，东吴证券研究所

本周申万电子各子行业中，其他电子板块上涨 5.07%、电子制造板块上涨 3.97%、光学光电子板块上涨 2.36%、半导体板块上涨 1.58%、元件板块下跌 1.94%、。

图 6：申万电子子行业本周涨跌幅



数据来源：Wind，东吴证券研究所

本周电子行业 140 支个股上涨，天华超净（27.24%）、深华发 A（26.67%）、拓邦股份（26.64%）涨幅居前；有 128 支个股下跌，欧菲光（-14.96%）、澜起科技（-14.37%）、精研科技（-11.32%）跌幅居前。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

图 7：电子行业本周股价涨跌幅前十标的

本周周涨幅前十位		本周周跌幅前十位	
公司名称	涨幅	公司名称	跌幅
天华超净	27.24%	欧菲光	-14.96%
深华发A	26.67%	澜起科技	-14.37%
拓邦股份	26.64%	精研科技	-11.32%
铜峰电子	24.95%	华映科技	-10.49%
科恒股份	21.50%	鹏鼎控股	-10.22%
亿纬锂能	20.16%	恒铭达	-9.47%
国光电器	18.68%	中光学	-9.38%
传音控股	17.47%	生益科技	-9.11%
华灿光电	16.96%	东山精密	-8.77%
*ST宇顺	15.77%	信维通信	-8.25%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

电子行业上市公司中，环旭电子、景旺电子和传音控股的机构持股比例居前，分别为 86.53%、81.85%和 81.28%。

图 8：电子行业 2020 年 Q1-Q3 机构持股比例前十标的

公司名称	机构持股比例（%）
环旭电子	86.53
景旺电子	81.85
传音控股	81.28
得邦照明	77.63
蓝思科技	76.14
睿能科技	75.00
世运电路	74.96
圣邦股份	73.66
可立克	73.50
深圳华强	73.43

数据来源：Wind，东吴证券研究所

请务必阅读正文之后的免责声明部分

3. 风险提示

1）市场需求不及预期：若电子产品应用市场需求不及预期，相关公司产品销售可能受到影响，从而影响公司营收的增长。

2）企业研发不及预期：电子行业相关产品研发的专业化程度较高，存在一定技术壁垒，技术开发难度和研发投入大，若新一代产品研发进度不及预期，相关公司核心业务的营收规模和增速可能受到影响。

3）市场开拓不及预期：由于下游需求放缓，导致相关公司与主要客户的稳定合作关系发生变动或市场开拓不及预期，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载，需征得东吴证券研究所同意，并注明出处为东吴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

东吴证券投资评级标准:

公司投资评级:

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15%以上;

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5%与 15%之间;

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与 5%之间;

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间;

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下。

行业投资评级:

增持： 预期未来 6 个月内，行业指数相对强于大盘 5%以上;

中性： 预期未来 6 个月内，行业指数相对大盘-5%与 5%;

减持： 预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于大盘 5%以上。

东吴证券研究所

苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址： http://www.dwzq.com.cn